

# 电子元器件系统级组装及研发制造基地项目防腐地坪工程III标段中标公示

(招标编号: JX2023ZB-G016)

## 一、中标人信息:

标段(包)[001]电子元器件系统级组装及研发制造基地项目防腐地坪工程III标段:

中标人: 深圳市中深装饰建设集团有限公司      中标价格: 682.003420 万元

## 二、其他:

受采购单位的委托, 我司对电子元器件系统级组装及研发制造基地项目防腐地坪工程III标段(项目编号: JX2023ZB-G016)进行了公开招标, 经评标委员会评审及采购单位确认, 将中标结果进行公示:

中标单位: 深圳市中深装饰建设集团有限公司

中标金额: 人民币陆佰捌拾贰万零叁拾肆元贰角 (¥6,820,034.20)

为体现“公开、公平、公正”的原则, 现对以上中标结果公示三日。招标机构联系人: 杨工;  
联系电话: 0755-82531482。

深圳市建星项目管理顾问有限公司

2023年9月5日

## 三、监督部门

本招标项目的监督部门为深南电路股份有限公司。

## 四、联系方式

招 标 人: 深南电路股份有限公司

地 址: 深南电路股份有限公司

联 系 人: 王工

电 话: 0755-82531482

电子邮件: 353674985@qq.com

招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

地 址：深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 16 楼东

联 系 人：杨工

电 话：82531482

电子邮件：594098761@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）